

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002 年 2 月 7 日 (07.02.2002)

PCT

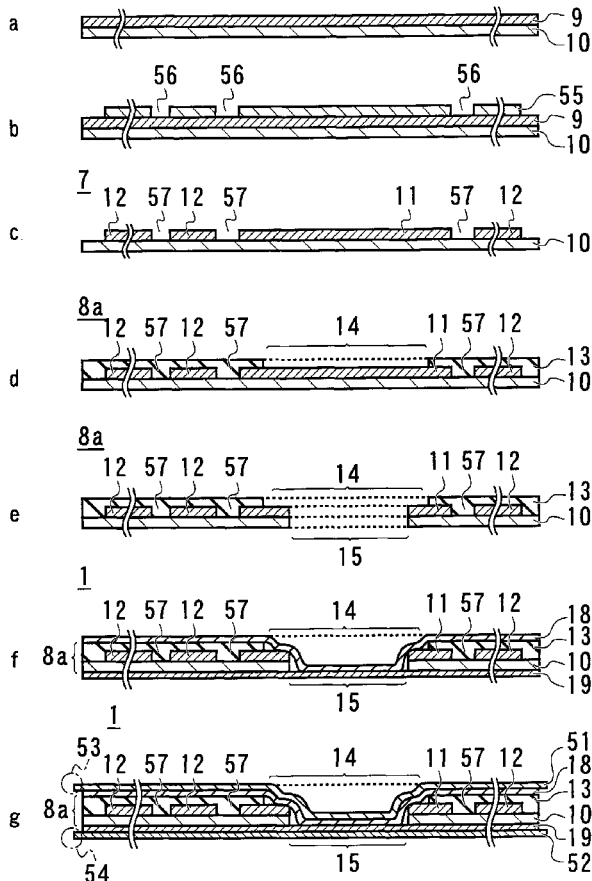
(10) 国際公開番号
WO 02/11501 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H05K 1/02, 9/00, H01B 7/08 7 103-8312 東京都中央区日本橋室町一丁目6番3号 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP01/06329
- (22) 国際出願日: 2001 年 7 月 23 日 (23.07.2001)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2000-226495 2000 年 7 月 27 日 (27.07.2000) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニーケミカル株式会社 (SONY CHEMICALS CORP.) [JP/JP];
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 上野祥史 (UENO, Yoshifumi) [JP/JP]. 滝川幸博 (TAKIKAWA, Yukihiro) [JP/JP]; 〒322-8501 栃木県鹿沼市さつき町18 ソニーケミカル株式会社 第1工場内 Tochigi (JP).
- (74) 代理人: 弁理士 石島茂男, 外 (ISHIJIMA, Shigeo et al.); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2番18号 虎ノ門興業ビル3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, ID, KR, SG, US.

[続葉有]

(54) Title: WIRING BOARD

(54) 発明の名称: 配線基板



(57) Abstract: A wiring board (1) having a flexibility, wherein a first shield film (18) is connected to an earth wiring (11) on the bottom surface of an opening (14) provided in a cover film (13) and also connected to a second shield film (19) through a through-hole (15) passing from the front surface side to the rear surface side of a base film (10), whereby the second shield film (19) is connected to the earth wiring (11) through the first shield film (18), and thus the entire wiring board (1) is shielded.

[続葉有]



添付公開書類：
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

本発明の配線基板（１）は可撓性を有しており、第１のシールドフィルム（１８）が、カバーフィルム（１３）に設けられた開口（１４）の底面で接地配線（１１）に接続されている。また、その第１のシールドフィルム（１８）は、ベースフィルム１０の表面側から裏面側まで貫通する貫通孔（１５）を会して第２のシールドフィルム（１９）に接続されている。従って、第２のシールドフィルム（１９）は、第１のシールドフィルム（１８）を介して接地配線（１１）に接続され、配線基板（１）全体がシールドされる。